SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Weidmüller ma már a csatlakozók egyik vezető nemzetközi iparági szállítója. A termékcsalád fontos tagjai a kerek csatlakozók, amelyeknek a Weidmüller az SAI összefoglaló terméknevet adta. Az SAI termékek fejlesztése során a Weidmüller mérnökei mindig az ésszerű, költséghatékony telepítési koncepcióra összpontosítottak, és a főbb felhasználókkal együttműködve jól átgondolt termékekkel látták el a piacot, amelyek világszerte új szabványt jelentenek a funkcionalitást és a minőséget tekintve. Az új teljesítményelosztókra a legjobb példa az S és T kódolású M12. Ezeket a modulokat a különösen nagy áram és feszültség jellemzi. Ezért például háromfázisú motorokhoz is használhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M8B-3-F9THR
Rendelési szám	2422800000
Verzió	Beépített dugók, M8, M 12, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4050118430103
Menny.	25 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 10:37:58 CEST

SAIE-M8B-3-F9THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	8,04 g

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Felszerelés típusa	Első rögzítés	Ház felülete	nikkelezett
Házak	M8 aljzat	Kódolás	M8 = nincs
Pólusszám	3	Rögzítőmenet	M10
Szerelési magasság	9 mm	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Névleges feszültség	60 V	Névleges feszültség (szöveg)	60 V (3 pólusú) / 30 V (4, 5 és 8 pólusú)
Névleges áram	4 A	Névleges áram	4 A
Hőmérsékleti tartomány	-30…80 °C	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Au (arany)	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M8	Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 Nm
Felerősítő menet	M10	Rögzítési nyomatéktartomány	0.8 Nm
Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással	Szigetelés erőssége	100 MΩ
Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Érintkező anyaga	CuZn	Tömítés anyaga	FPM
Záróanya anyaga	Nikkelezett CuZn	Peremes szerelésű ház anyaga	Nikkelezett CuZn
Kiöntőanyag	PUR		

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Au (arany)

Rendszerparaméterek

Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Pólusszám	3	Szigetelés erőssége	100 MΩ
Védelmi osztály	IP67	Érintkezősorok száma	1

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP

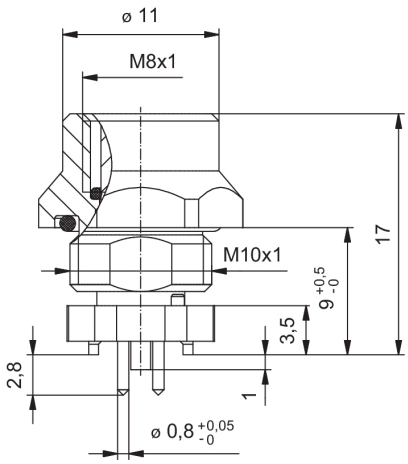
A létrehozás dátuma 2019. július 24. 10:37:58 CEST

SAIE-M8B-3-F9THR

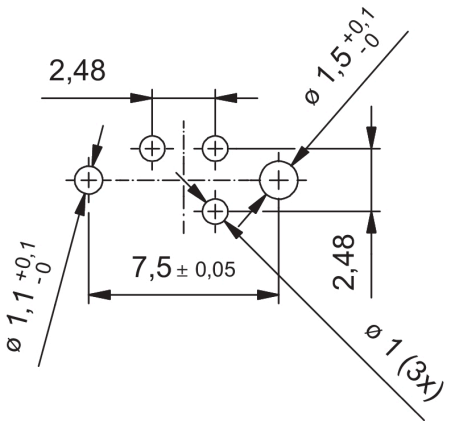
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

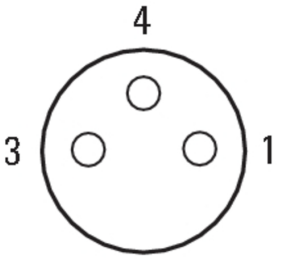
Méretrajz



NYÁK kivitel



Póluskiosztás



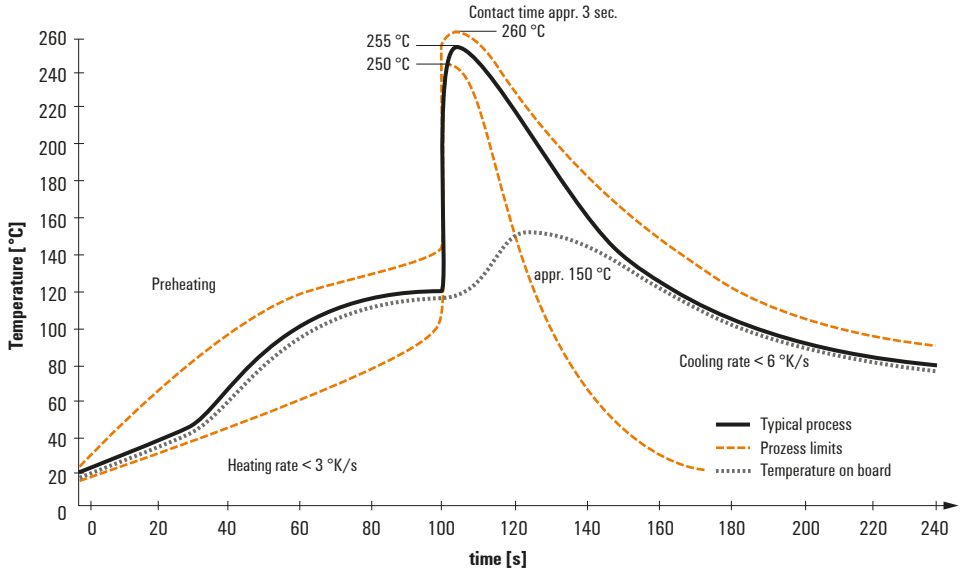
A létrehozás dátuma 2019. július 24. 10:37:58 CEST

Wave Solder Profile

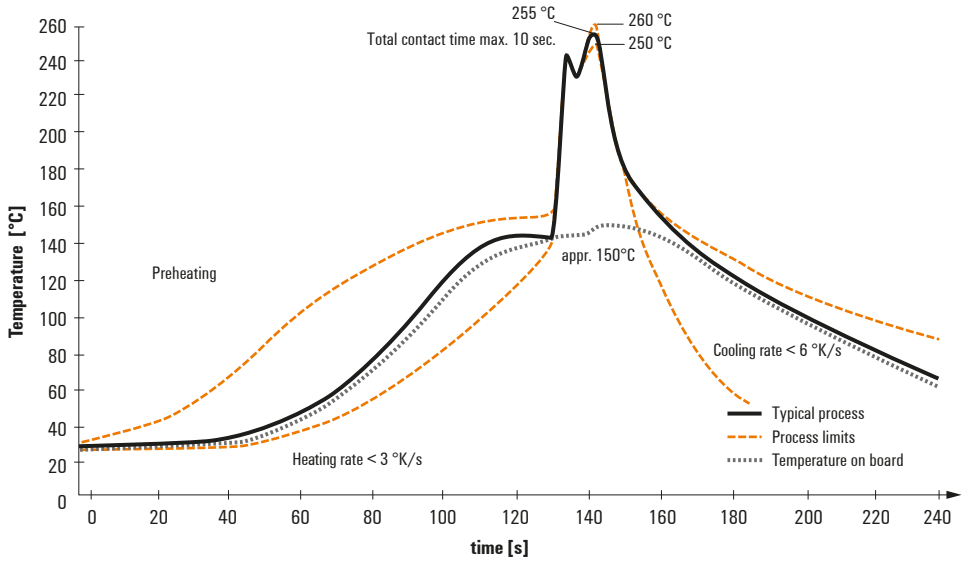
Recommended wave solderding profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

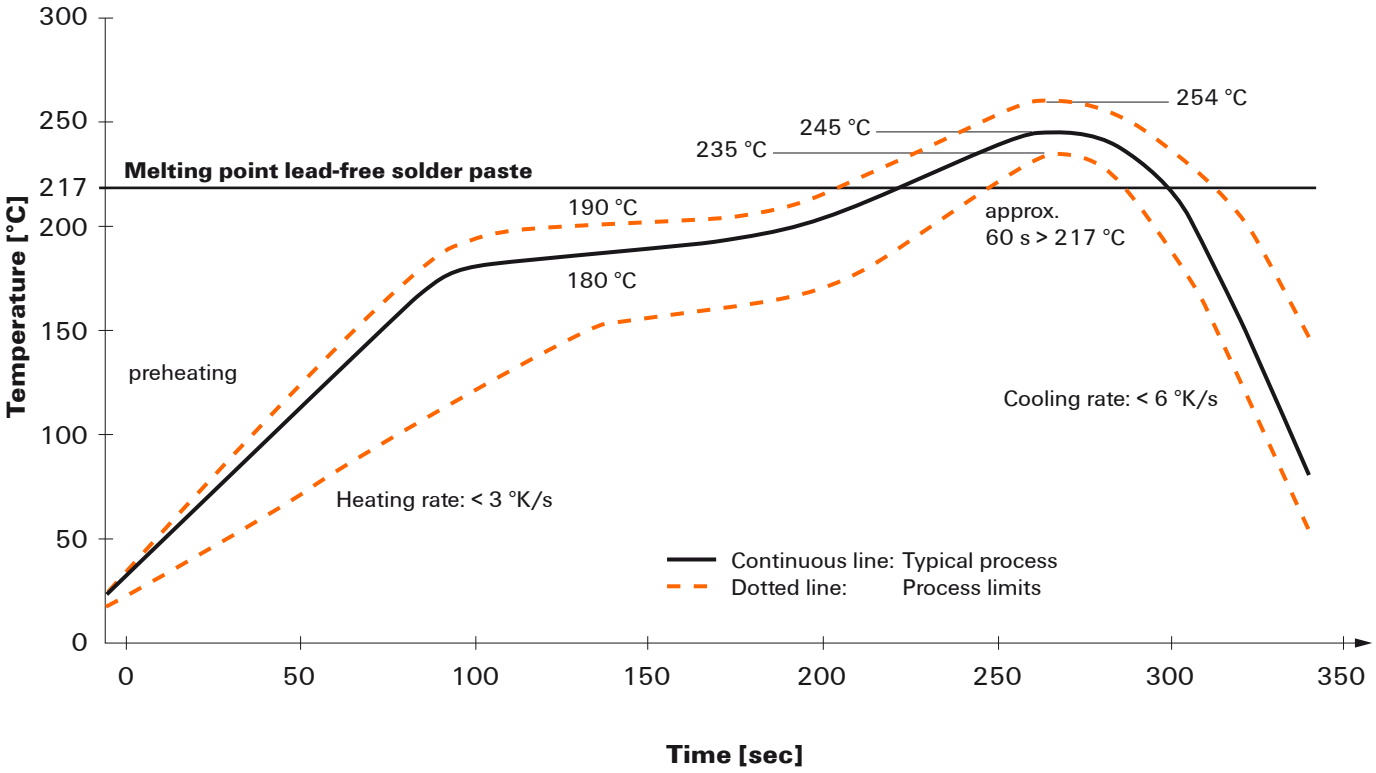
The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Reflow Solder Profile

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.